

Lead free devices from Diotec

Several EU directives (ELV, ROHS, WEEE) are forcing manufacturers to reduce respectively avoid the usage of hazardous substances in electronic devices, such as the widely used lead (Pb) for semiconductors. For Diotec products there is the following roadmap to comply with the requirements of the above directives:

- **Already „lead free“** are: parts in glass packages DO-35, SOD-80 (glass MiniMelf), see IMDS (<http://www.diotec.com/> – „Products“ – „IMDS“)!
- **All parts** are already **solderable with lead free processes**, as long as the allowed soldering parameters are not exceeded (max 260°C for no longer than 5 s, see databook Edition 18, page 15)
- **Lead free devices** in compliance to ROHS (i. e. outer lead finish Sn96,5Ag3,2Cu0,3) will be offered by Diotec **from spring 2004 on**.

A more detailed description of these items can be found on the English version of our website at <http://www.diotec.com/> – „Products“ – „Lead Free Devices“).

Bleifreie Bauteile von Diotec

Diverse EU-Richtlinien (ELV, ROHS, WEEE) schreiben ab dem **01. Juli 2006** die Reduzierung bzw. Vermeidung von gefährlichen Substanzen in elektronischen Geräten vor, darunter auch das bei Halbleiterbauelementen weit verbreitete Blei (Pb). Für Diotec-Produkte gilt folgender „Fahrplan“ zur Erreichung der in den Richtlinien genannten Forderungen:

- **Bereits „bleifrei“**: Bauteile in den Glasgehäusen DO-35, SOD-80 (MiniMelf Glas), siehe IMDS (<http://www.diotec.com/> – „Produkte“ – „IMDS“)!
- **Alle Bauteile** sind jetzt schon mit **bleifreien Lötprozessen verarbeitbar**, solange die zulässigen Lötparameter (max. 260°C für nicht länger als 5 s, siehe Datenbuch Edition 18 S. 15) eingehalten werden
- **Bleifreie Bauteile** in Übereinstimmung mit ROHS (d. h. äußere Verzinnung Sn96,5Ag3,2Cu0,3) wird Diotec **ab Frühjahr 2004** anbieten

Eine ausführlichere Beschreibung dieser Thematik findet sich im Internet unter <http://www.diotec.com/> – „Produkte“ – „Bleifreie Bauteile“).

